

山西红外键合机

生成日期: 2025-10-28

根据型号和加热器尺寸，EVG500系列键合机可以用于碎片和50mm至300mm的晶圆。这些工具的灵活性非常适合中等批量生产、研发，并且可以通过简单的方法进行大批量生产，因为键合程序可以转移到EVGGEMINI大批量生产系统中。键合室配有通用键合盖，可快速排空，快速加热和冷却。通过控制温度，压力，时间和气体，允许进行大多数键合过程。也可以通过添加电源来执行阳极键合。对于UV固化黏合剂，可选的键合室盖具有UV源。键合可在真空或受控气体条件下进行。顶部和底部晶片的独立温度控制补偿了不同的热膨胀系数，从而实现无应力黏合和出色的温度均匀性。在不需要重新配置硬件的情况下，可以在真空下执行SOI/SDB（硅的直接键合）预键合。Smart View® NT-适用于GEMINI和GEMINI FB，让晶圆在晶圆键合之前进行晶圆对准。山西红外键合机

**EVG510
晶圆键合机**



岱美仪器技术服务（上海）有限公司
键合机、光刻机、膜厚仪、干涉仪、轮廓仪、隔振台、位移传感器

EVG®6200键合机选件 自动对准 红外对准，用于内部基板键对准 NanoAlign®包增强加工能力 可与系统机架一起使用 掩模对准器的升级可能性 技术数据 常规系统配置 桌面 系统机架：可选 隔振：被动 对准方法 背面对准 $\pm 2\mu\text{m}3\sigma$ 透明对准 $\pm 1\mu\text{m}3\sigma$ 红外校准：选件 对准阶段 精密千分尺：手动 可选：电动千分尺 楔形补偿：自动 基板/晶圆参数 尺寸：2英寸，3英寸，100毫米，150毫米，200毫米 厚度：0.1-10毫米 最/高堆叠高度：10毫米 自动对准 可选的 处理系统 标准：3个卡带站 可选：最多5个站山西红外键合机同时EVG研发生产的的GEMINI系统是使用晶圆键合的量产应用的行业标准。

EVG6200 BA 自动键合对准系统



岱美仪器技术服务（上海）有限公司


键合机、光刻机、膜厚仪、干涉仪、轮廓仪、隔振台、位移传感器

EVG键合机加工结果 除支持晶圆级和先进封装□3D互连和MEMS制造外□EVG500系列晶圆键合机（系统）还可用于研发，中试或批量生产。它们通过在高真空，精确控制的准确的真空，温度或高压条件下键合来满足各种苛刻的应用。该系列拥有多种键合方法，包括阳极，热压缩，玻璃料，环氧树脂□UV和熔融键合□EVG500系列基于独特的模块化键合室设计，可实现从研发到大批量生产的简单技术转换。 模块设计 各种键合对准（对位）系统配置为各种MEMS和IC应用提供了多种优势。使用直接（实时）或间接对准方法可以支持大量不同的对准技术。

ComBond自动化的高真空晶圆键合系统，高真空晶圆键合平台促进“任何物上的任何东西”的共价键合特色技术数据□EVGComBond高真空晶圆键合平台标志着EVG独特的晶圆键合设备和技术产品组合中的一个新里程碑，可满足市场对更复杂的集成工艺的需求ComBond支持的应用领域包括先进的工程衬底，堆叠的太阳能电池和功率器件到高端MEMS封装，高性能逻辑和“beyondCMOS”器件ComBond系统的模块化集群设计提供了高度灵活的平台，可以针对研发和高通量，大批量制造环境中的各种苛刻的客户需求量身定制ComBond促进了具有不同晶格常数和热膨胀系数□CTE□的异质材料的键合，并通过其独特的氧化物去除工艺促进了导电键界面的形成ComBond高真空技术还可以实现铝等金属的低温键合，这些金属在周围环境中会迅速重新氧化。对于所有材料组合，都可以实现无空隙和无颗粒的键合界面以及出色的键合强度。自动键合系统EVG®540□拥有300 mm单腔键合室和多达4个自动处理键合卡盘。

EVG540 全自动晶圆键合机



 岱美仪器技术服务(上海)有限公司
键合机、光刻机、膜厚仪、干涉仪、轮廓仪、隔振台、位移传感器

GEMINI自动化生产晶圆键合系统集成的模块化大批量生产系统，用于对准晶圆键合特色技术数据GEMINI自动化生产晶圆键合系统可实现最高水平的自动化和过程集成。批量生产的晶圆对晶圆对准和最大200毫米（300毫米）的晶圆键合工艺都在一个全自动平台上执行。器件制造商受益于产量的增加，高集成度以及多种键合工艺方法的选择，例如阳极，硅熔合，热压和共晶键合。特征全自动集成平台，用于晶圆对晶圆对准和晶圆键合底部IR或Smaiew对准的配置选项多个键合室晶圆处理系统与键盘处理系统分开带交换模块的模块化设计结合了EVG的精密对准EVG所有优点和®500个系列系统与独力系统相比，占用空间最小可选的过程模块LowTemp™等离子活化晶圆清洗涂敷模块紫外线键合模块烘烤/冷却模块对准验证模块技术数据最大加热器尺寸150、200、300毫米装载室5轴机器人最高键合模块4个最高预处理模块200毫米：4个300毫米：6个EVG键合机可以使用适合每个通用键合室的专用卡盘来处理各种尺寸晶圆和键合工艺。山西红外键合机

EVG®500系列键合模块-适用于GEMINI支持除紫外线固化胶以外的所有主流键合工艺。山西红外键合机

长久键合系统 EVG晶圆键合方法的引入将键合对准与键合步骤分离开来，立即在业内掀起了市场**。利用高温和受控气体环境下的高接触力，这种新颖的方法已成为当今的工艺标准EVG的键合机设备占据了半自动和全自动晶圆键合机的主要市场份额，并且安装的机台已经超过1500个EVG的晶圆键合机可提供最/佳的总拥有成本TCO并具有多种设计功能，可优化键合良率。针对MEMS3D集成或gao级封装的不同市场需求EVG优化了用于对准的多个模块。下面是EVG的键合机EVG500系列介绍。

山西红外键合机

岱美仪器技术服务(上海)有限公司属于仪器仪表的高新企业，技术力量雄厚。公司致力于为客户提供安全、质量有保证的良好产品及服务，是一家其他有限责任公司企业。公司业务涵盖半导体工艺设备，半导体测量设备，光刻机 键合机，膜厚测量仪，价格合理，品质有保证，深受广大客户的欢迎。岱美中国顺应时代发展和市场需求，通过**技术，力图保证高规格高质量的半导体工艺设备，半导体测量设备，光刻机 键合机，膜厚测量仪。